

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 12 月 1 日(01.12.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/148628 A1

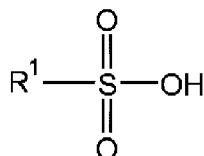
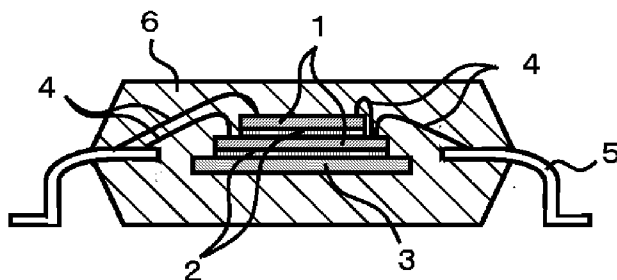
- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08F 8/14 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08F 210/14 (2006.01) H01L 25/065 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) H01L 25/07 (2006.01)
C08L 23/26 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/002906
- (22) 国際出願日: 2011 年 5 月 25 日(25.05.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-122191 2010 年 5 月 28 日(28.05.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田部井 純一(TABEL, Jun-ichi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T Gビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR-SEALING EPOXY RESIN COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING SAME

(54) 発明の名称: 半導体封止用エポキシ樹脂組成物およびこれを用いる半導体装置

[図1]



(1)

(57) Abstract: The disclosed semiconductor-sealing resin composition contains a compound comprising the following esterified by a C₅₋₂₅ alcohol in the presence of a compound represented by general formula (1): (A) an epoxy resin; (B) a hardener; (C) an inorganic filler; and (D) a copolymer of a C₅₋₈₀ 1-alkene and maleic anhydride. In general formula (1), R¹ is a C₁₋₅ alkyl group, a C₁₋₅ alkyl halide group, or a C₆₋₁₀ aromatic group.

(57) 要約: 本発明によれば、(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 無機充填材、及び (D) 炭素数 5 ~ 80 の 1-アルケンと無水マレイン酸との共重合物を、一般式 (1) で示される化合物の存在下で、炭素数 5 ~ 25 のアルコールでエステル化した化合物を含む半導体封止用エポキシ樹脂組成物が提供され、ここで一般式 (1) において、R¹は、炭素数 1 ~ 5 のアルキル基、炭素数 1 ~ 5 のハロゲン化アルキル基、および炭素数 6 ~ 10 の芳香族基からなる群から選ばれる。



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))